

円星科技 (M31)2026 年第二季在线法人说明会 Q&A 完整实录

主讲人：总经理 张原熏

Q1：请总经理说明 2027 年的营运展望（包含营收成长、毛利率、费用规划以及整体的获利能力发展方向）

答：2027 年的前提仍是先完成 2026 年下半年的营收目标。展望明年，权利金将是公司最重要的成长动能。不论是先进制程或成熟制程的新权利金收入，都将来自不同 Foundry（晶圆厂）与 Fabless（非晶圆厂）客户，成长来源相对多元。

在 RD 人数及研发费用方面，公司将持续控管。随着权利金占比提高，公司可更有效率地规划客户需求与新开案，若费用控制与权利金成长都能如预期进行，明年营收与获利能力都有机会进一步提升。

此外，先进制程 IP、高阶 Consumer、Automotive、AI/HPC 相关应用以及高阶 SerDes，将是 2027 年的重要产品方向。总结来说，希望权利金成长，能够让过去几年的投入开始带来更好的回收成果。

Q2：关于第二季表现未达预期的主因与未来能见度？公司目前对于营收成长趋势是否可以持续？对未来需求能见度有何看法以及中长期的发展前景？下半年营运最大的挑战是什么？

答：上半年最大的瓶颈在于新开案推进速度不如预期。目前公司洽谈中的案件数量很多，但从讨论到正式签约的时程明显拉长，因此造成部分案件延后认列。我们观察到北美、欧洲、日本及韩国客户的进度相对缓慢，但认为这些需求并未消失，而是时程递延，因此有机会在下半年逐步补回。中长期来看，公司仍持续推动权利金占比提升，希望由目前十几个百分点逐步提高至接近 20%，并在明年挑战超过 20%。当权利金模式逐渐成熟后，公司未来将不需要依赖持续扩编 RD 来换取营收，获利结构也可望显著改善。

Q3：上半年营收达标率较不理想，目前是否仍维持原先的年度成长指引？有设定单月营收的低标吗？另外，过去一年展望与实际成果的落差，会如何总结并优化预测流程，以避免外界期待与实际营收的落差？

答：公司仍维持原先设定的年度成长目标不变。

若以上半年完成约 40%的进度来看，下半年必须完成剩余约 60%的营收目标，这是公司目前最重要的经营任务。

发布单位：円星科技股份有限公司

发布日期：2026/8/12

对于过去展望与实际成果之间的落差，确实需要检讨与改善。未来将持续强化与客户间的沟通及需求确认，加快客户决策与案件收敛速度。

同时，在合约签订或工作说明书产出后到正式签约的流程也会持续优化，希望缩短中间作业时间，降低预测与实际结果之间的落差。

Q4：有没有什么授权金的项目进程可以分享？

答：经过过去几年的投入与布局，公司预期下半年将正式切入台湾主要晶圆代工厂最先进制程平台，目前已取得相关合作资格，预计第三季开始陆续签订新的合作案。

除了既有客户之外，公司近期也持续与主要晶圆代工厂深化合作，希望能在更多客户导入最先进制程时参与相关项目。

管理层认为，不论是 A14 或 2 奈米，都有机会于今年下半年看到新案展开。此外，3 奈米至 8 奈米区间的 IP 产品布局也逐渐完整，从今年下半年到明年上半年仍会是重要的授权金来源。

Q5：请公司分享目前 7 奈米以下的先进制程案件发展情况。以及 2026 上半年与下半年的开案数占比是否会有明显变化？

答：7 奈米以下目前已是公司最重要的发展方向。目前超过 80% 的研发项目皆聚焦于先进制程领域，我们也期待未来先进制程相关营收占比能够持续提高。

不过进入先进制程之后，开案数不一定会增加。由于客户投入成本大幅提高，因此开案频率通常较成熟制程低。公司的重点不在于案件数量增加，而是在于提升每个案件的价值，希望每笔项目金额都能显著高于过去。

Q6：对先进制程后续布局的计划是什么？以及因为先进制程的开发成本比较高，有没有其他的因应对策？

答：公司整体研发资源仍以先进制程为重心。不过，公司不会为了扩大产品线而开发大量缺乏市场需求的 IP，而是优先投入具备商业化机会与客户需求的产品。

面对开发成本提高，我们将更加重视 IP 的商业价值与市场需求，「能否顺利销售」将和技术能力同等重要。

此外，公司也持续加强产品质量与可靠度，因为先进制程产品一旦出现问题，其代价远高于过去，因此质量管理与验证能力将是未来的重要工作。

发布单位：円星科技股份有限公司

发布日期：2026/8/12

Q7: 2 奈米和 3 奈米权利金今年的收取情况与贡献度为何？先前提到 2 奈米的案子最快将在今年底贡献营运，目前有没有新的 Tape-out（设计定案）完成呢？

答：今年上半年公司的先进制程权利金已有明显提升，主要来自 3 奈米案件开始进入贡献阶段。至于 2 奈米部分，目前已知客户完成 Tape-out，后续将观察实际量产动能。若量产时程顺利，最快有机会在今年第四季至明年第一季开始看到 2 奈米权利金收入贡献。

Q8: 目前中国大陆车载/自驾系统的进度如何？

答：公司在中国车用市场已有一定布局，包括影音传输与自驾系统等领域。目前已有多家采用 M31 IP 的客户，在 N6、N5 及 4 奈米平台上的首颗芯片开发进展顺利，相关需求仍持续增加。此外，许多客户在第一代产品完成后，也开始规划功能扩充及下一代产品，因此可望持续带来新的开案需求。管理层对中国车用市场仍维持正面看法，未来也希望进一步扩大客户基础。

Q9. 台湾龙头晶圆代工厂（台积电）的先进制程营收占比已经达到近八成，但为什么 M31 的权利金却没有随之大幅成长？

答：首先需要澄清的是，市场提到的「八成」并不是指 M31 在台积电先进制程平台上的市占率达到八成。公司与台积电的合作确实持续从 12 奈米、6 奈米逐步推进至 4 奈米等先进制程节点，但距离台积电整体客户群实际采用比例仍有相当大的差距。

未来公司希望透过更多客户采用 M31 IP，进一步累积权利金收入。现阶段最重要的工作，是确保每一位采用 M31 IP 的客户，不论是透过 Foundry 或 Design House 导入，都能够为公司带来持续性的权利金贡献。

Q10. 请总经理分享对安森美（Onsemi）收购 Synaptics 相关业务的看法，以及对 M31 的影响？

答：Onsemi 与 Synaptics 目前都是 M31 的客户，其中 Synaptics 更是 M31 早期在北美市场的重要客户之一。就目前来看，双方的合作关系并未受到影响，既有合作仍持续进行中。

未来若收购完成后产生更多 IP 导入、开发或合作需求，公司也希望能够进一步参与相关机会。

Q11. 投资人非常关心，想请总经理说明和信骅科技日后的合作计划。

答：信骅一直以来都是 M31 非常重要的合作伙伴。双方自 2017 年开始合作，从 BMC 芯片到 Cupola 3D Camera 等产品，都有 M31 IP 的导入与合作。多年来不论管理团队或研发团队都建立

发布单位：円星科技股份有限公司

发布日期：2026/8/12

了良好的合作默契，因此这次能够邀请信骅参与私募，公司也认为非常荣幸。

未来双方将持续聚焦于 Server 相关产品及芯片合作，M31 也将依照信骅的需求，提供更多客制化 IP 产品来支持其发展。同时，透过 Server 相关 IP 的合作，公司也有机会接触到过去较难切入的新客户，并透过信骅的产业资源与客户关系，进一步与美系大型客户展开交流与合作。

Q12. 第一季曾提到公司针对 Edge AI 未来应用已进行完整 IP 布局，是否计划参与 Data Center 基础建设？例如与半导体厂商合作光通讯，或与韩系内存大厂在先进制程方面的合作？

答：除了 Edge AI 之外，公司目前也持续布局 Data Center 与光通讯市场。今年上半年的一项重要进展，是聚焦于 PCIe Gen5、Gen6、Gen7 等高阶 SerDes 技术，未来也希望进一步跨足 112G SerDes，以切入光通讯及 CPO 等相关应用。

在客户布局方面，目前韩系内存大厂已经采用 M31 的产品，后续仍有进一步扩大合作的空间。至于美系先进制程客户，公司也持续投入资源，不论成熟制程或先进制程都希望增加覆盖率，并期待下半年有机会与市场分享新的进展。

Q13. 请总经理分享一下美国客户高阶订单的认列进度，或北美 CSP（云端服务供货商）开案的最新进度与展望？

答：美国客户在极先进制程开案时，决策流程与讨论时间相对较长，因此案件推进速度也较一般案件慢。以目前掌握的情况来看，公司期待在第三季完成最新一代合作案的签署。

至于 CSP 方面，公司持续与相关客户接触，同时透过 Design Service 公司的合作资源，建立更多与 CSP 客户的连结。由于这些合作伙伴与大型云端客户关系密切，因此有助于公司进一步切入相关项目。若后续有进一步成果，公司也将再向市场更新。

Q14. 想请问 M31 在特用芯片（ASIC）的接案状况如何？

答：公司不会特别区分 ASIC Design Service 公司或 Fabless 客户。对 M31 而言，只要客户有 IP 需求，不论是设计服务公司或自行开发芯片的 Fabless 业者，皆属于潜在合作对象。

目前公司与台湾主要 ASIC House 均已建立成熟合作关系，而未来的重要发展方向之一，就是持续将 IP 产品拓展至美系大型芯片设计服务公司。

去年公司已与一家北美客户展开第一个合作案，目前也正在探讨新的 3 奈米项目合作机会。

Q15. 众多推论芯片（Inference Chip）的 SRAM 设计，有没有可能采用公司的 IP？还是通常会

发布单位：円星科技股份有限公司

发布日期：2026/8/12

选择自行设计？

答：公司目前拥有相当完整的 SRAM 开发团队，主要仍以与 Foundry（晶圆厂）共同合作的产品开发模式为主。

随着 AI 推论芯片及先进制程需求持续增加，公司近期确实接获更多高阶 SRAM 的客制化需求。不论是 2 奈米、3 奈米甚至更先进的制程节点，公司都希望持续投入相关产品开发并争取更多导入机会。若未来有进一步成果，也会适时向市场分享。